

Systemy klejenia okładzin ceramicznych i kamiennych

Przewodnik

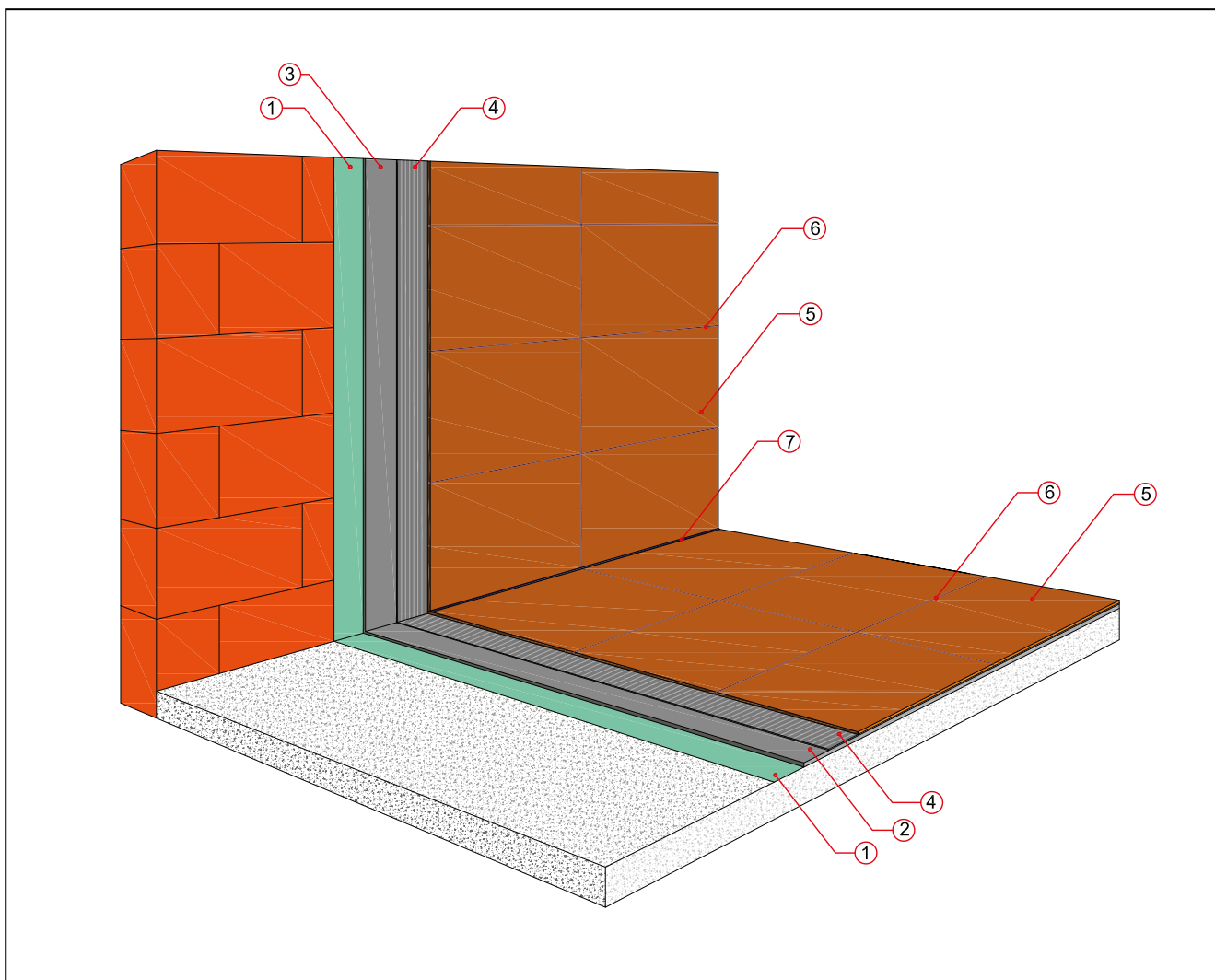


A brand of

BASF

We create chemistry

19. Płytki wielkoformatowa



Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Grunt	PCI Gisogrund	Grunt dyspersyjny do podłoża chłonnych
2	Zaprawa wyrównująca posadzkę	PCI Pericem 515	Cementowa masa poziomująca
3	Zaprawa wyrównująca ścianę	PCI Pericret	Szpachlówka cementowa
4	Klej do płytek	PCI Nanolight	Uniwersalny klej cementowy klasy S1
		PCI Flexmörtel S2	Wysokoelastyczny klej cementowy klasy S2
5	Płytki		
6	Fuga	PCI Nanofug Premium	Elastyczna fuga cementowa
		PCI Pericolor Flex	Elastyczna fuga cementowa
7	Uszczelniacz	PCI Silcofug E	1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obciążenia

Okladziny płytkowe wielkoformatowe występują na ścianach i posadzkach we wnętrzach obiektów o różnej funkcji: mieszkalnych, biurowych, handlowych (sklepy, galerie handlowe), wystawowych, użyteczności publicznej itp. Bliższa charakterystyka warunków eksploatacji i obciążeń znajduje się w rozdziale „01. Płytki na podłożu nieodkształcalnym” (strona 2). Jako „wielkoformatowe” przyjęto umownie płytki o przynajmniej jednym boku dłuższym niż 60 cm. Poniższe zalecenia odnoszą się także do wszystkich wydłużonych płytek prostokątnych, tzn. takich, dla których proporcja długości boku dłuższego do boku krótszego wynosi minimum 4:1.

Podłoże

Zakłada się, iż podłoże jest nieodkształcalne, tzn. stanowi je cementowy lub anhydrytowy jastrych posadzkowy, a w przypadku ścian tynk mineralny: zazwyczaj cementowy, wapienno-cementowy lub gipsowy. Wymienione podłoża winny być czyste, nośne, pozbawione rys i wykruszeń. Jastrychy anhydrytowe należy koniecznie przeszlifować i odpylić. Okładziny wielkoformatowe wymagają bardzo dokładnego wyrównania podłoża, np. masami poziomującymi lub szpachlówkami. W razie konieczności szybkiego wyrównania, można tego dokonać na posadzkach cementową masą poziomującą **PCI Pericem 515**, na ścianach natomiast cementową szpachlówką **PCI Pericret**. Produkty te umożliwiają kontynuację robót już po kilku dniach, a nawet kilku godzinach. W kwestii dylatacji patrz podrozdział „Podłoże” w rozdziale „01. Płytki na podłożu nieodkształcalnym” (strona 2).

Wykonawstwo

A. GRUNTOWANIE

Patrz punkt „A. GRUNTOWANIE” w rozdziale „01. Płytki na podłożu nieodkształcalnym” (strona 2).

B. WYKLEJENIE PŁYTEK

Do mocowania okładziny (zazwyczaj gresowej) należy stosować uniwersalny cementowy klej klasy C2TE S1 wg PN-EN 12004 **PCI Nanolight** lub wysoko elastyczny cementowy klej klasy C2TE S2 - **PCI Flexmörtel S2**. Na posadzkach, które będą poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym, wynikającym np. z intensywnego ruchu wózków ręcznych lub pochodzącym od ciężkich mebli, regałów sklepowych itp., zaleca się przyklejanie płytek metodą kombinowaną.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: **PCI Nanofug Premium** lub **PCI Pericolor Flex**. Szerokość fug zależy od rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny. W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym **PCI Silcofug E**. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca się wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym **PCI Elritan 140**, gruntując go od strony płytek środkiem **PCI Elastoprimer 145**. Pod uszczelniaczem umieścić wałek dylatacyjny, np. **DIN Polyband 08**.

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.